

ネプコン ジャパン 2025

第2回 パワーデバイス&モジュールEXPO

2025/1/22(Wed)-24(Fri) 10:00-17:00

東京ビッグサイト
東7ホール

ブース番号

E69-52



出展内容のご紹介

01 ダイボンダー

Shanghai Techsense Co., Ltd. (日本販売:ジェニーステック株式会社)

マルチダイボンダー MCB-3000

- ✓ IGBTモジュールのデザインにフレキシブルに対応可能
- ✓ 多彩な部品供給ユニットを選択可能
- ✓ フレキシブルなラインレイアウトへの対応
- ✓ 高精度かつハイコストパフォーマンスを実現

多彩な部品供給に対応できるプラットフォーム

- ✓ ウェハー
- ✓ JEDEC
- ✓ リール
- ✓ ワッフル
- ✓ リボンソルダー

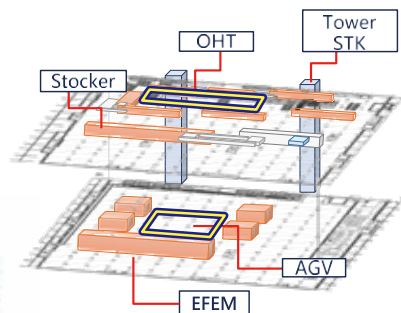
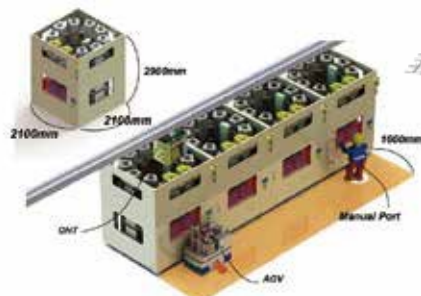


02 自動搬送システム

MYSES Co., Ltd. (日本販売:ジェニーステック株式会社)

Malaysia Semiconductor System

- ✓ 中国、台湾で設計、マレーシアで製作、設置、アフターサービスを対応。
- ✓ 半導体工場の自動化でニーズの高い、AGV・AMR・OHT・EFEM・ストッカー・リフターなどのトータルソリューションを提供。
- ✓ 専用ソフトウェアも充実。
- ✓ 中国、台湾、マレーシアなどで大手客先への納入実績多数。



03 超音波溶着機

SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd.

アルミ線ワイヤーボンダー IG-6000-B

特徴

- ☑ Y軸は高精度ガントリプラットフォームにおける2軸同期制御
- ☑ 溶接品質のリアルタイム監視
- ☑ 磁気バネによる重力補正(Z軸負荷軽減及び部品長寿命化)
- ☑ Z軸円筒形リニアモーター採用(負荷軽減、溶着前の衝撃低減)
- ☑ オンライン圧力補正技術、高速圧力補正、リアルタイム圧力検出
- ☑ 後カット、前カットを選択可能
- ☑ 操作容易なソフトウェア



04 塗布システム

Axxon Automation Co., Ltd.

高精度ディスペンスシステム MYD50X

特徴

- ☑ **柔軟性** MYDシリーズは、特定のプロセス要件を満たすために、異なる基板サイズや組成を扱うことができます。チルトや回転、接触および非接触加熱、デュアルヘッド構成などのオプション機能により、数多くのアプリケーションを実現可能。
- ☑ **コスト効率** 小型化された装置寸法、高品質な構造、合理化された機械設計により、メンテナンスとダウンタイムを低減しながら、システムを長期間稼働させることができます。当社のピエゾジェティング技術は、摩耗部品の数を減らして設計されており、MYDシリーズをコスト効率の高いディスペンスシステムにしています。
- ☑ **生産性の向上** 精密な温度制御、オン・ザ・フライ・フィデューシャルサーチ、堅牢なビジョンアルゴリズム、低モーションZ軸、非接触ディスペンスなど、生産性を向上させる特長があります。



05 自動機

Pentamaster Technology (M) Sdn. Bhd.

モジュールテストソリューション PM52-T ファイナルテストハンドラー

高温機能を備えた様々なタイプのパワーモジュールに対して、ISO試験やAC/DC試験を含むハイパワー試験を提供しています。

- ☑ UPH >1000 (テスト時間:2秒)
- ☑ インプット、アウトプット: メタルトレイ、プリスタートレイ、プラスチックチューブスタッカー
- ☑ オールインワンソリューション テスト、ビジョン、ハンドリング
- ☑ テストカバレッジはISO、AC/DC全対応
- ☑ 高度なAOI(2Dピン/3Dピン検査、ヒートシンク反り検査)
- ☑ 常温/高温テスト (25°C~175°C)



第一実業株式会社
DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
URL: <https://www.djk.co.jp/>



自動車事業本部 デバイスシステム部 (八木)
〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目1番1号 中日ビル21階
TEL:052-728-5474 E-mail:automotive@djk.co.jp